享受《若干政策》第（六）条的集成电路生产企业和财关税〔2021〕4号文提及的关键原材料、零配件

生产企业申报材料目录

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **材料** |
| 1 | 系统生成纸质文件 |
| 2 | 企业情况说明（参考模板1） |
| 3 | 企业法人营业执照副本 |
| 4 | 企业取得的其他相关资质证书（可提供相应查询网址） |
| 5 | 项目备案文件（备案表）（可提供相应查询网址） |
| 6 | 企业承诺书（系统下载） |
| 7 | 企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料（包括采购设备清单等）（参考模板2） |
| 8 | 先进封装、测试企业提供按封装产品颗粒数或晶圆数（折合8 英寸）计算，先进封装测试（晶圆级封装、系统级封装、2.5 维和3 维封装）规划产能占总规划产能比例不低于40%的证明材料 |
| 9 | 市发改委（市工信局）要求出具的其他材料 |

纸质材料装订建议

1. 按照材料目录顺序胶装，并用彩页隔开各项内容；

2. 如有特殊情况，请附上加盖公章的情况说明；

3. 封面及书脊注明“申报年度+类别+公司名称”（如:2022年度享受《若干政策》第（六）条的集成电路线宽小于65纳米（含）的逻辑电路生产企业：XX公司）；

4．封面上留下联系人及联系电话；

5. 如分册装订，请注明“共XX册，第XX册”；

电子光盘按材料类别建立文件夹，以材料名称命名文件名（如一、系统生成的纸质文件），审计报告及专项审计报告、测试报告、合同等涉及多页的文档按份扫描成PDF格式（不要一张一个图片或者文件）。

**参考模板1**

**XXX公司情况说明**

提纲（包括但不限于）：

一、企业业务简介

从公司成立背景、核心技术、主要产品、业务特点、主要客户或服务对象、商业模式等方向进行简要描述。

二、其他需要说明的事项

联系人/职务/手机：

公司名称（盖章）：

年 月 日

**参考模板2**

**企业具有保证产品生产的手段和能力证明材料**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **提供商/国别** | **设备型号** | **数量（台/套）** | **自购/租用** |
| **一、硬件设备** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、软件设备** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **三、场地** | | | | | |
| **位置** |  | | **面积** |  | |

**注：除上表外，还需提供具有保证产品生产手段和能力的文字简述（包括但不限于研发及生产水平，集成电路生产企业具有保证相关工艺线宽产品生产的手段和能力，先进封装测试企业具有先进封装测试产品生产的手段和能力，结合软硬件设备对产品研发生产手段和能力介绍）、软硬件设备及研发生产场地照片、采购合同等证明材料。**